

## LISTADO DE SOLICITUDES CON RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN

### Segunda Convocatoria ICV/ME 2025 Sección General

EXPEDIENTE	CIF	RAZÓN SOCIAL	TÍTULO DEL PROYECTO	FINANCIABLE	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO
MIE-010100-2025-0001	B84454776	NEW INFRARED TECHNOLOGIES,S.L.	"PICMIR - Sensores de infrarrojo medio monolíticamente integrados en plataformas fotónicas de silicio. Monolithically Integrated MIR sensors on Si Photonic Platforms"	<b>966.958,43 €</b>	<b>676.870,90 €</b>	0 €
MIE-010300-2025-0001	A39460118	ACORDE TECHNOLOGIES, S.A.	APOLO - Estudio de viabilidad para el diseño, implementación y explotación comercial de una arquitectura de microcontrolador optimizada y certificable para su uso en front-ends y equipos de comunicaciones embarcados de nueva generación en aeronáutica	<b>516.785,26 €</b>	<b>361.749,68 €</b>	0 €
MIE-010100-2025-0002	B97564348	Analog Devices, S.L.U.	Infraestructura Ethernet segura para el control remoto de dispositivos en vehículos definidos por software	<b>1.319.476,96 €</b>	<b>659.738,48 €</b>	0 €
MIE-010100-2025-0003	B67401513	QUALITY PHOTONIC OPTICS S.L.	INVESTIGACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE ENCAPSULADO DE CHIPS Y MICROELECTRÓNICA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE MECANISMOS DE CIBERSEGURIDAD FÍSICA DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS	<b>582.118,00 €</b>	<b>407.482,60 €</b>	0 €
MIE-010100-2025-0004	B75218040	MULTIVERSE COMPUTING SL	Secure-by-Design AI Chips for Critical Infrastructures	<b>21.294.730,50 €</b>	<b>12.776.838,30 €</b>	0 €
MIE-010300-2025-0002	B31732951	Montajes, mantenimientos y automatismos eléctricos Navarra, S.L.	Sistema electrónico inteligente para el mecanizado preciso y estable de materiales compuestos destinados al sector aeronáutico	<b>520.517,26 €</b>	<b>312.310,32 €</b>	0 €



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

Plan de Recuperación,  
Transformación  
y Resiliencia



EXPEDIENTE	CIF	RAZÓN SOCIAL	TÍTULO DEL PROYECTO	FINANCIABLE	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO
MIE-010300-2025-0003	B10742195	GIESECKE + DEVRIENT MOBILE SECURITY TCD IBERIA S.L.	Post-quantum secure identity	<b>840.560,30 €</b>	<b>420.280,00 €</b>	0 €
MIE-010100-2025-0006	B71307722	DAS-NANO TECH, S.L.	Estudio teórico-experimental de la Interacción Materia-TeraHercio para su caracterización En la industria de los SEMiconductores	<b>618.582,34 €</b>	<b>433.007,64 €</b>	0 €
MIE-010100-2025-0007	B95609814	SYSTEM-ON-CHIP ENGINEERING S.L.	IP CORE SPACEWIRE RESILIENTE A EFECTOS DE RADIACIÓN IONIZANTE ESPACIAL	<b>611.398,06 €</b>	<b>305.698,95 €</b>	0 €
MIE-010100-2025-0008	B83844878	RBZ ROBOT DESIGN S.L.	Investigación de un Sistema Robótico de Medición e Inspección Multiespectral para Procesos de Fabricación de Semiconductores (IRIS-SEM)	<b>583.531,12 €</b>	<b>408.471,78 €</b>	0 €
MIE-010200-2025-0001	B10742195	GIESECKE + DEVRIENT MOBILE SECURITY TCD IBERIA S.L.	SUNRISE - Nuevas funcionalidades de aprovisionamiento y gestión segura de perfiles eSIM para chips eUICC + eSE	<b>2.274.043,45 €</b>	<b>568.510,86 €</b>	0 €
MIE-010100-2025-0010	B87353074	Wave and Particle Engineering Solutions, S.L.	Desarrollo y fabricación de bloques básicos de tecnología para moduladores avanzados en plataforma de GaAs (DEMOGAAS)	<b>557.969,75 €</b>	<b>390.578,83 €</b>	0 €
MIE-010100-2025-0011	B64127855	N-VISION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES SL	NEMESIS - Arquitectura de Aceleración Edge IA basada en Near Memory Computing	<b>1.006.353,35 €</b>	<b>704.447,35 €</b>	0 €
MIE-010100-2025-0012	B67281808	MS TECH EMEA, S.L.U	Investigación de una tecnología europea de encapsulado óptico de alta precisión en sistemas microelectrónicos avanzados (OBSIDIAN)	<b>2.215.672,11 €</b>	<b>1.550.970,49 €</b>	0 €



Financiado por  
la Unión Europea  
NextGenerationEU

**R** Plan de Recuperación,  
Transformación  
y Resiliencia



EXPEDIENTE	CIF	RAZÓN SOCIAL	TÍTULO DEL PROYECTO	FINANCIABLE	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO
MIE-010300-2025-0005	B67429670	QILIMANJARO QUANTUM TECH SL	Estudio de viabilidad para el desarrollo de un Assembly Design Kit (ADK) híbrido para la integración de procesadores cuánticos analógicos y digitales	<b>704.281,18 €</b>	<b>422.568,71 €</b>	0 €
MIE-010100-2025-0013	B01753763	Inmersia Computers S.L.	See4DFabls: Plataforma para Microdisplays Tridimensionales	<b>1.041.258,31 €</b>	<b>728.880,82 €</b>	0 €
MIE-010300-2025-0006	A15010176	TELEVES S.A.	Estudio de Viabilidad orientado al Diseño, Desarrollo y Fabricación de un Chip de Alto Rendimiento para el Procesado Digital de Señales de Radiofrecuencia (VISTA)	<b>736.025,06 €</b>	<b>368.012,00 €</b>	0 €
MIE-010100-2025-0014	B86359791	TINÁMICA S.L.	Investigación de Cores IP modulares postcuánticos para comunicación segura mediante túneles criptográficos "on-demand" (Cores-Brigde-PQC)	<b>1.039.827,39 €</b>	<b>727.879,00 €</b>	0 €
MIE-010100-2025-0015	B67378471	Technica Electronics Barcelona S.L.	IP PARA ARQUITECTURAS ZONALES DE MULTIPLES NODOS CONECTADOS MEDIANTE PROTOCOLOS DE CONTROL REMOTO SECURIZADOS - CRESEC	<b>775.703,00 €</b>	<b>387.851,50 €</b>	0 €
MIE-010200-2025-0003	B80414634	SATLINK S.L.	SATSoC: Desarrollo experimental de un nuevo SoC para comunicaciones satelitales en boyas inteligentes	<b>1.134.369,55 €</b>	<b>283.592,39 €</b>	0 €
MIE-010100-2025-0018	B88145941	Tierra Audio S.L.	Exodus Core: Chip de comunicaciones postapocalípticas con encriptación post-cuántica y capacidades fotónicas.	<b>661.555,32 €</b>	<b>463.088,72 €</b>	0 €
MIE-010100-2025-0019	B87078069	WOOPTIX SL	Extensión del rango espectral de los sistemas de imagen de alta resolución en fase de frente de onda (VISION25)	<b>516.641,81 €</b>	<b>361.649,26 €</b>	0 €

EXPEDIENTE	CIF	RAZÓN SOCIAL	TÍTULO DEL PROYECTO	FINANCIABLE	SUBVENCIÓN	PRÉSTAMO
MIE-010100-2025-0020	B60355948	MONOCROM S.L.	"Procesos Fotónicos para Obleas Semiconductoras" - FOTOBLEA	<b>601.431,40 €</b>	<b>360.858,84 €</b>	0 €
MIE-010100-2025-0022	B95673406	SHERPA EUROPE SL	FENIX: Federated Electronics and semicoNductors with artificial IntelliXence	<b>623.902,84 €</b>	<b>436.732,00 €</b>	0 €
MIE-010100-2025-0026	A88434774	MAKING BEST COLORS CHEMICAL INDUSTRIES, S.A	Investigación de tecnologías avanzadas especializadas en detección molecular basadas en resonancia magnética nuclear RMN, y prototipado electrónico para el diseño de ASICs (CircularASIC-μRMN)	<b>669.918,47 €</b>	<b>468.942,00 €</b>	0 €
MIE-010300-2025-0008	B22956999	VANTELIS TECHNOLOGIES, S.L.	CHAOS SOC, Chaos Based Security System-on-Chip for OT	<b>1.159.514,65 €</b>	<b>811.660,26 €</b>	0 €
MIE-010100-2025-0025	B91079384	TELEDYNE INNOVACIONES MICROELECTRONICAS S.L.U.	Diseño de un sensor de imagen científico con ultra-alta velocidad en tecnología CMOS de 65 nanómetros "3D stacked" para secuenciación de ADN.	<b>2.719.219,00 €</b>	<b>1.359.609,50 €</b>	0 €
MIE-010100-2025-0024	B91079384	TELEDYNE INNOVACIONES MICROELECTRONICAS S.L.U.	UHSIP Siglas en inglés de "Ultra-High Speed Area Scan Image Sensor for IPs Development" o, en español, "Sensor de área de ultra-alta velocidad para el desarrollo de IPs".	<b>3.308.712,00 €</b>	<b>1.654.356,00 €</b>	0 €
MIE-010200-2025-0004	B88034392	Alcyon Photonics SL	Photonblock	<b>940.904,42 €</b>	<b>423.406,98 €</b>	0 €
MIE-010100-2025-0009	B88425236	SILBAT ENERGY STORAGE SOLUTIONS, S.L.	Desarrollo de módulos fotovoltaicos de alta eficiencia	<b>514.422,10 €</b>	<b>360.095,47 €</b>	0 €